

2024.02

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

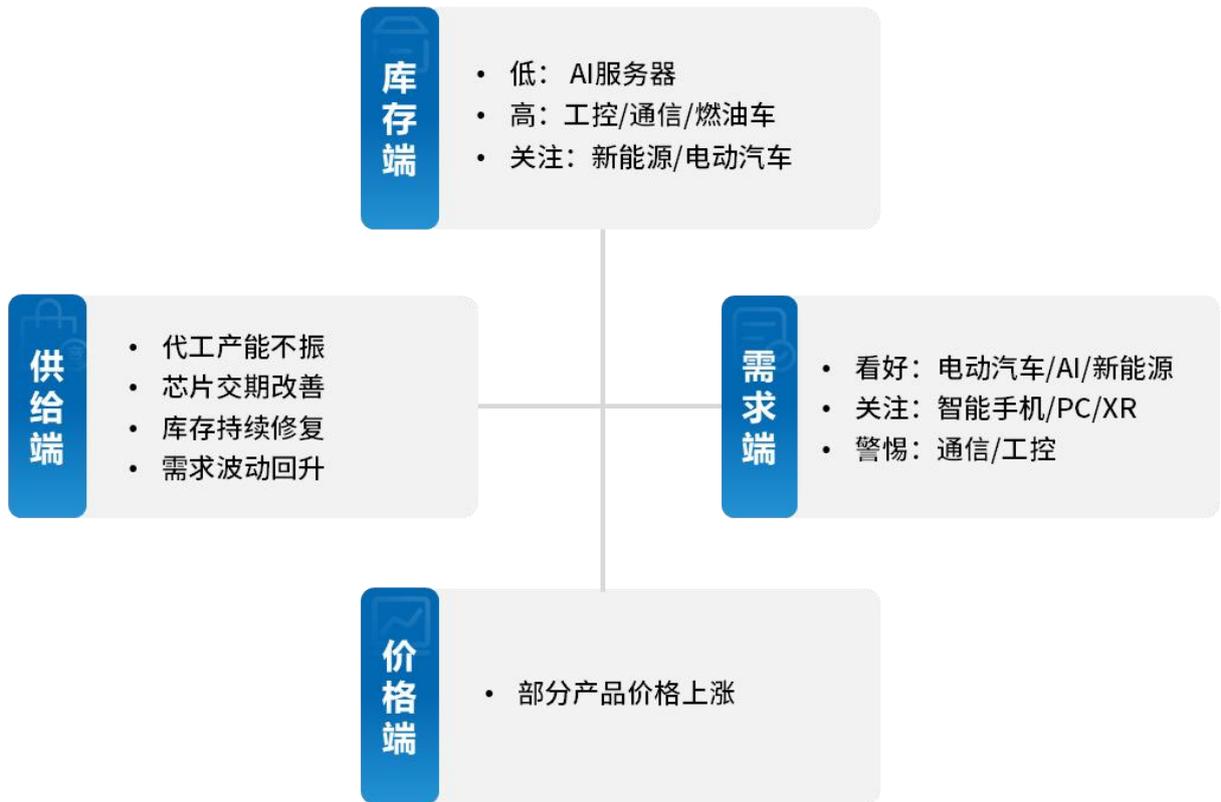
序章	2
一、2月宏观经济	2
1、全球制造业持续改善，不确定性存在	2
2、电子信息制造业降幅收窄，趋势向好	3
3、半导体销售强劲反弹，市场预期上升	4
二、2月芯片交期趋势	6
1、整体芯片交期趋势	6
2、重点芯片供应商交期一览	7
三、2月订单及库存情况	12
四、2月半导体供应链	13
1、半导体上游厂商	13
(1) 硅晶圆/设备	13
(2) 原厂	14
(3) 晶圆代工	15
(4) 封装测试	16
2、分销商	17
3、系统集成	17
4、终端应用	18
(1) 消费电子	18
(2) 新能源汽车	19
(3) 工控	20
(4) 光伏	20
(5) 储能	21
(6) 服务器	21
(7) 通信	22
五、分销与采购机遇及风险	22
1、机遇	22
2、风险	23
六、小结	23
免责声明	24

图表目录

图表 1: 2月全球主要经济体制造业 PMI	3
图表 2: 2023年最新电子信息制造业运行情况	3
图表 3: 2023年最新全球半导体行业销售额及增速	4
图表 4: 2018-2023年全球及中国集成电路产量情况	5
图表 5: 2023年中国集成电路细分产品进出口情况	5
图表 6: 2月费城及申万半导体指数走势	6
图表 7: 2月芯片交期趋势	7
图表 8: 2月主要厂商交期及趋势一览	7
图表 9: 2月头部企业订单及库存情况	13
图表 10: 2月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况	14
图表 11: 2月主要原厂最新动态	14
图表 12: 2月主要晶圆代工厂最新动态	15
图表 13: 2月主要封测厂商最新动态	17
图表 14: 2月主要元器件分销商最新动态	17
图表 15: 2月主要系统集成商最新动态	17
图表 16: 2月消费电子厂商最新动态	19
图表 17: 2月新能源汽车厂商最新动态	19
图表 18: 2月工控厂商最新动态	20
图表 19: 2月光伏厂商最新动态	20
图表 20: 2月储能厂商最新动态	21
图表 21: 2月服务器厂商最新动态	21
图表 22: 2月通信厂商最新动态	22
图表 23: 2月细分市场机会关注	23
图表 24: 2月细分市场风险预警	23

序章

波动调整持续

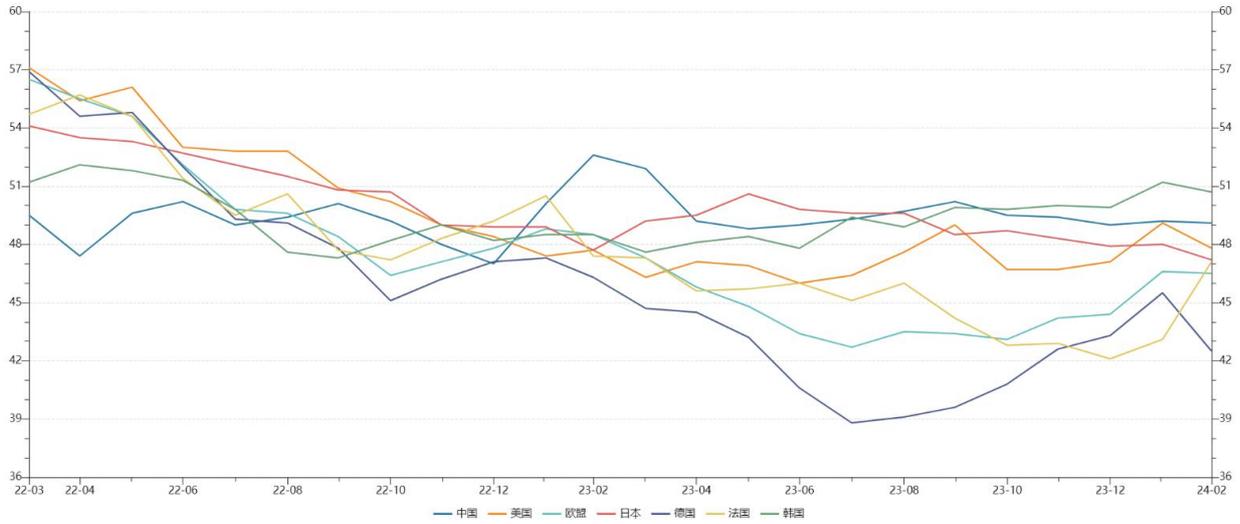


一、2月宏观经济

1、全球制造业持续改善，不确定性存在

2月，全球经济指数升幅明显，经济恢复力度有所提升。但中国、美国、欧盟、日本、法国及德国等主要经济体仍处于警戒线之下，不确定性依然存在。

图表 1：2 月全球主要经济体制造业 PMI



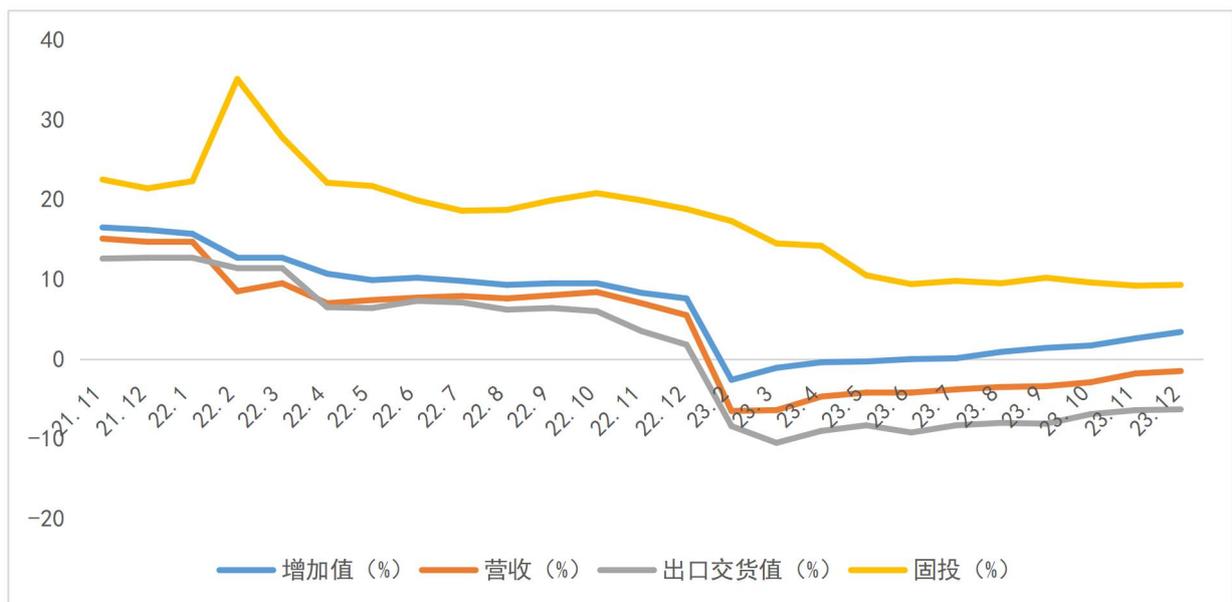
资料来源：国家统计局

IMF 最新预测，2024 年全球经济将继续保持恢复韧性，经济增长为 3.1%。

2、电子信息制造业降幅收窄，趋势向好

2023 年，中国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，投资平稳增长，多区域营收降幅收窄。

图表 2：2023 年最新电子信息制造业运行情况

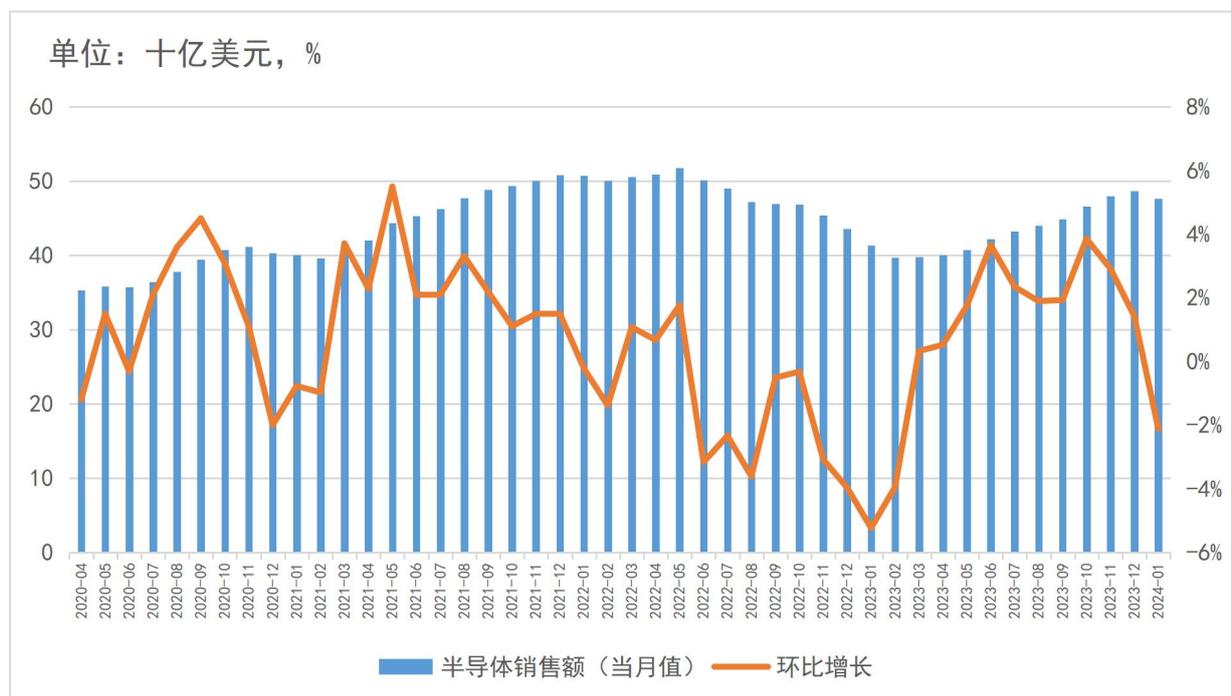


资料来源：工信部

3、半导体销售强劲反弹，市场预期上升

根据 SIA 最新数据，2024 年 1 月全球半导体行业销售额为 476.3 亿美元，同比增长 15.2%，环比下降 2.1%。从地区来看，中国销售额同比增长 26.6%，表现最佳，美洲次之，销售同比增长 20.3%。SIA 预计，2024 年开年全球半导体销售强劲，几个月内销售可望持续成长，全年全球半导体产业销售额将增长 13.1%。

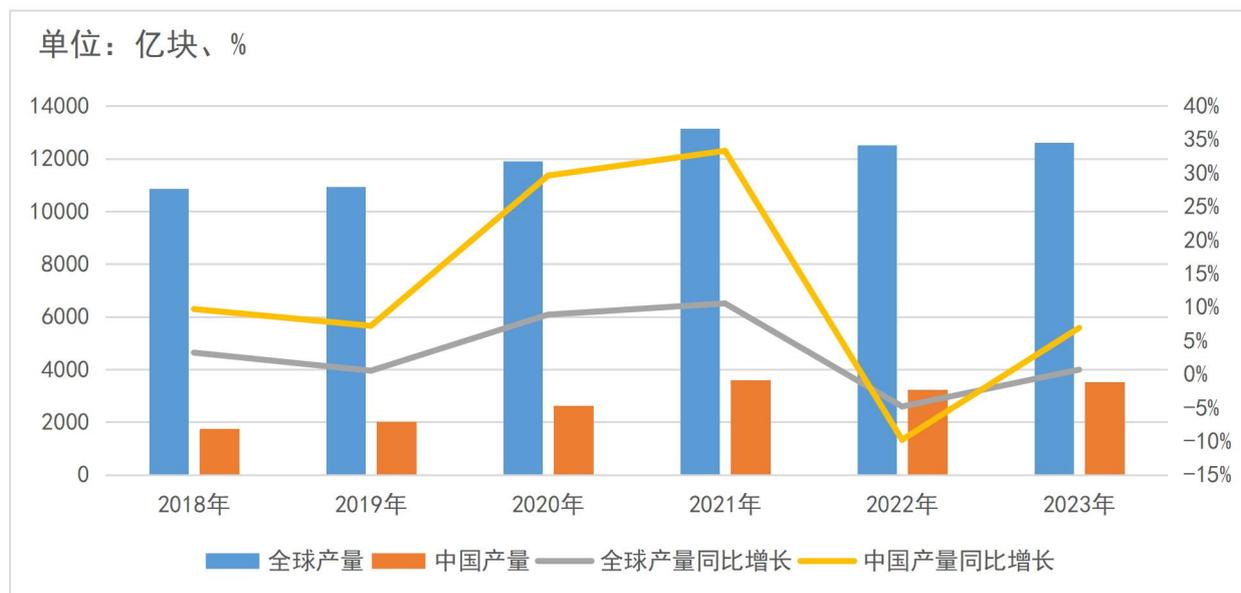
图表 3：2024 年最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看，2023 年全球集成电路产量恢复上涨趋势，其中中国集成电路产量为 3514 亿块，同比增长 6.9%。

图表 4：2018–2023 年全球及中国集成电路产量情况



资料来源：工信部、CSIA、SIA、芯八哥整理

进出口方面，2023 年，我国集成电路进出口数量、金额、单价普遍下滑。中国台湾和韩国仍是我国集成电路的主要来源地，受美国对中国高端芯片限制影响，从美国进口集成电路连续两年下滑幅度最大。从细分元器件看，处理器及控制器贸易逆差 1263 亿美元，存储器贸易逆差 231 亿美元，可以看出我国集成电路对外依赖度非常高，尤其是处理器及控制器方面。

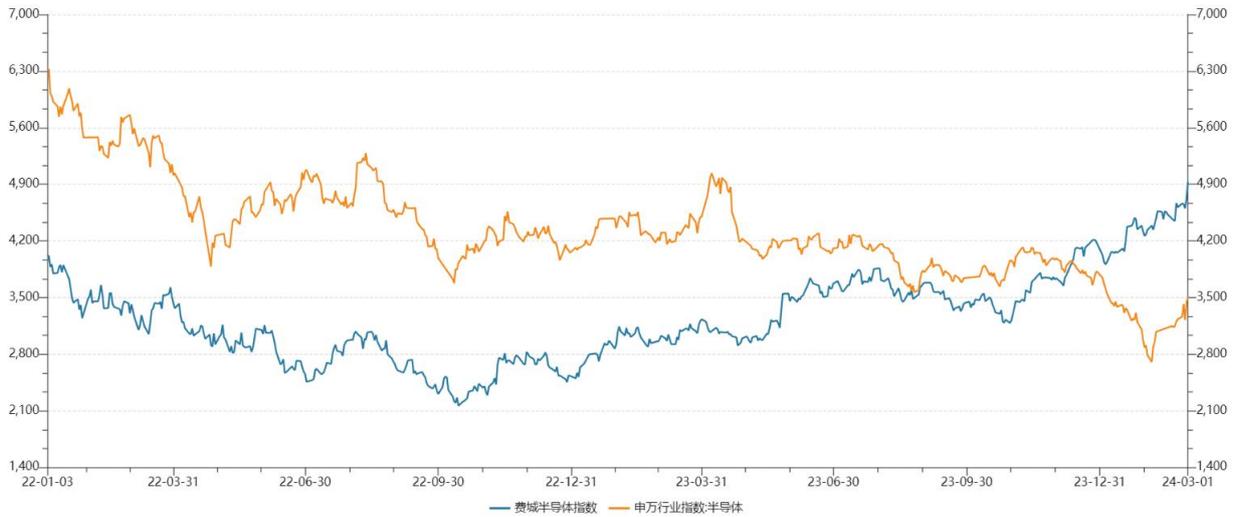
图表 5：2023 年中国集成电路细分产品进出口情况

产品	进口额 (亿美元)	出口额 (亿美元)	进口同比增长	出口同比增长
处理器及控制器	1763	500	-14%	-5%
存储器	789	558	-22%	-21%
放大器	122	35	-20%	-13%
其他	820	268	-13%	-2%
集成电路零件	8	4	-12%	-35%

资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理

从资本市场指数来看，2 月费城半导体指数 (SOX) 上涨 15.17%，中国半导体 (SW) 行业指数上涨 20.58%。显示当前国内外投资者对市场预期看好。

图表 6：2月费城及申万半导体指数走势



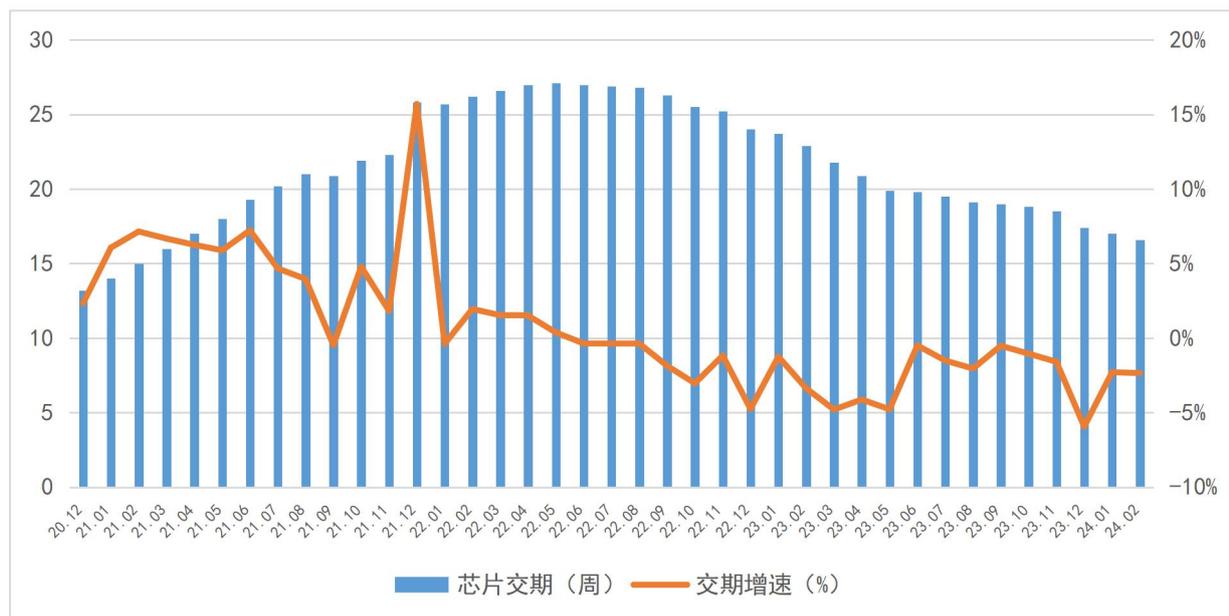
资料来源：Wind

二、2月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

2月，全球芯片交期持续下降，供应情况持续改善，但部分品类有明显波动。

图表 7：2月芯片交期趋势



资料来源：SFG、芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

从2月各供应商看，模拟芯片、消费MCU成交低迷，价格倒挂严重；MOSFET、IGBT及MCU等车规级产品需求趋缓，交期改善明显；FPGA、射频产品价格有小幅波动，需求回升；存储产品价格回升，需求稳定。

图表 8：2月主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	8-24	8-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	20-32	20-32	稳定	稳定
		开关稳压器	20-45	20-45	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	14-24	14-24	缩短	稳定
	Infineon	传感器	18-52	18-52	稳定	上升
		开关稳压器	20-52	20-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
		汽车模拟和电源	45-52	45-52	稳定	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和数据转换器	15-30	15-30	缩短	上升
		接口	18-30	18-30	缩短	上升
		开关稳压器	20-30	20-30	缩短	稳定
	Microchip	放大器和数据转换器	4-10	4-10	缩短	稳定
		定时	7-12	7-12	缩短	稳定
		开关稳压器	4-25	4-25	缩短	上升
	MPS	开关稳压器	20-42	20-42	缩短	稳定
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	20-30	20-30	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	24-35	24-35	缩短	稳定
	On Semi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	18-26	18-26	缩短	稳定
		定时	20-42	20-42	稳定	稳定
		多源模拟/电源	20-40	20-40	稳定	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
	Renesas	放大器和数据转换器	24-36	24-36	缩短	稳定
		定时	50	50	稳定	稳定
		接口	24-36	24-36	缩短	稳定
		开关稳压器	36-40	36-40	缩短	上升
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	稳定
	ST	传感器	12-18	12-18	缩短	稳定
		放大器和数据转换器	14-24	14-24	缩短	稳定

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
		据转换器				
		多源模拟/电源	20-42	20-42	缩短	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	40-52	40-52	稳定	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
射频和无线	Infineon	蓝牙模块	26-36	26-36	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	16-26	16-26	稳定	稳定
		蓝牙模块	12-26	12-26	稳定	稳定
		收发器/接收器	18-20	18-20	稳定	上升
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Laird	WiFi 模块	20-40	20-40	稳定	稳定
		天线	12-16	12-16	延长	稳定
	ST	蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
		RFID	20	20	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	13	13	稳定	稳定
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定
On Semi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定	
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	8-16	8-16	缩短	根据市场调整
		TVS 二极管	8-14	8-14	缩短	稳定
		桥式整流器	8-30	8-15	稳定	稳定
		肖特基二极管	14-20	8-12	缩短	稳定
		整流器	8-30	8-13	稳定	稳定

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关二极管	12-20	8-12	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	12-30	8-12	缩短	稳定
		齐纳二极管	12-20	8-12	缩短	稳定
		双极晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		数字晶体管 /RETS	12-20	8-12	缩短	稳定
		通用晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		逻辑器件	8-10	8-10	稳定	稳定
	Infineon	低压 MOSFET	10-36	10-36	缩短	根据市场 调整
		高压 MOSFET	12-40	12-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	稳定	稳定
		宽带隙 MOSFET	26-52	26-52	稳定	稳定
		数字晶体管 /RETS	6-50	6-50	稳定	稳定
		通用晶体管	6-50	6-50	稳定	稳定
		军用-航空 晶体管	22-52	22-52	稳定	稳定
	ST	低压 MOSFET	50-54	50-54	缩短	稳定
		高压 MOSFET	14-40	14-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	缩短	稳定
		ESD	21-32	21-32	缩短	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定
		晶闸管 /Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极管	25-30	25-30	稳定	根据市场 调整
		整流器	14-16	14-16	稳定	稳定
		双极晶体管	40-52	40-52	稳定	稳定
		Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	4-20	4-20	缩短

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
		ESD	6-18	6-18	稳定	稳定
		肖特基二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		开关二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		小信号 MOSFET	8-16	8-16	缩短	稳定
		齐纳二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		双极晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
		数字晶体管 /RETS	4-16	4-16	缩短	稳定
		通用晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
MCU	Renesas	8 位 MCU	12-18	12-18	缩短	稳定
		32 位 MCU	18	18	缩短	稳定
		汽车	45	45	稳定	稳定
		32 位 MPU	18-26	18-26	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	35-52	10-24	缩短	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MPU	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32F0	10-12	10-12	缩短	稳定
		STM32F1	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32L	16-20	16-20	缩短	稳定
	Infineon	32 位 MCU	20-28	10-20	缩短	稳定
		8 位 MCU	10-14	10-14	缩短	稳定
		汽车	紧缺	紧缺	稳定	稳定
	Microchip	8 位 MCU	10-52	10-52	缩短	稳定
		32 位 MCU	4-16	4-16	缩短	稳定
		32 位 MPU	4-28	4-28	缩短	稳定
NXP	32 位 MPU	4-24	4-24	稳定	稳定	
	8 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定	
	32 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定	
	汽车	18-52	18-52	稳定	稳定	
		32 位 MPU	18-52	18-52	缩短	稳定

类别	供应商	产品	24.2 交期/周	24.3 交期/周	交期趋势	价格趋势
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	20-50	20-50	缩短	稳定
	Intel (Altera)		30-55	20-35	稳定	稳定
	Lattice		28-42	20-30	缩短	稳定
	Microchip (Microsemi)		10-44	10-44	缩短	稳定
存储器	Samsung	DRAM (商用PC)	52-54	52-54	稳定	稳定
		存储器模块	52-54	52-54	稳定	稳定
		eMMC	52-54	52-54	稳定	稳定
		固态驱动器 (SSD)	52-54	52-54	稳定	稳定
	SK Hynix	NAND flash	6-10	6-10	缩短	根据市场调整
		eMMC	8-12	8-12	稳定	稳定
被动元件	Murata	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
		引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
	TDK	滤波器	12-16	12-16	延长	稳定
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容 (车规级)	30-42	30-42	稳定	稳定

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、2月订单及库存情况

从企业订单需求看，车规类芯片订单有所下降，库存波动明显；工业、通信类芯片需求低迷；消费类芯片订单保持稳定。

图表 9：2 月头部企业订单及库存情况

公司	24.2 订单	24.2 库存	24.3 订单趋势	24.3 库存趋势
Intel	稳定	一般	稳定	一般
AMD	稳定	一般	稳定	一般
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	稳定	一般	上升	一般
TI	下降	较高	根据市场调整	较高
ST	下降	一般	根据市场调整	一般
ADI	稳定	低	上升	一般
Qualcomm	稳定	一般	根据市场调整	一般
Broadcom	稳定	一般	根据市场调整	低
NXP	根据市场调整	一般	根据市场调整	较低
Infineon	根据市场调整	一般	根据市场调整	较低
Renesas	稳定	低	根据市场调整	一般
onsemi	根据市场调整	无	稳定	低
Microchip	下降	一般	稳定	一般
Micron	稳定	一般	上升	一般
SK Hynix	稳定	一般	上升	一般
Murata	稳定	低	稳定	稳定
MTK	稳定	一般	根据市场调整	一般

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、2 月半导体供应链

设备/材料需求稳定，代工产能低迷，原厂订单波动，终端持续回暖。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

2 月，硅晶圆需求低迷，设备需求稳定，关注最新政策管控变化。

图表 10：2月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	2月订单	2月库存	3月订单预测
设备	ASML	稳定	低	上升
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	稳定
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

2月，核心厂商看好2024年AI及存储需求增长，消费类需求持续回升，汽车订单需求趋缓，工业和通信需求低迷。

图表 11：2月主要原厂最新动态

厂商	2月动态
Intel	预计24年AI PC出货量约4000万台；服务器加速芯片订单超20亿美元
AMD	MI300芯片销售超预期
NVIDIA	AI GPU交付周期缩至3-4个月；2024-2025年AI订单仍供不应求
TI	裁撤位于北京和深圳的芯片设计团队
Qualcomm	24Q1手机业务持续回升，但短期内库存仍然较高
三星	24Q1 SoC和高像素CIS订单将保持强劲，DDIC库存改善
MTK	2024年全球手机低速增长
Broadcom	38亿美元出售远程接入部门给KKR
ADI	汽车业务持续增长；已下单台积电熊本厂芯片产能

厂商	2月动态
ST	汽车业务有所放缓，工业需求较弱；2023年SiC营收同比增长超60%
Infineon	工业领域持续库存去化，通信及IoT需求低迷；汽车领域24H2完成库存消化后恢复增长
NXP	24H1汽车个工业需求疲软，预计24H2汽车和工业需求将恢复增长；24Q1公司工厂产能利用率约70%
Microchip	工业等终端客户需求持续低迷
onsemi	预计24Q1工业、汽车需求环比高个位数下降；公司终端市场处于库存消化和需求放缓时期
Renesas	59.1亿美元收购PCB设计公司Altium
KIOXIA	拟扩大闪存产量，结束2022年以来的减产
SK Hynix	2024年存储下游库存和出货量均将持续改善，HBM供应已售罄
Micron	开始批量生产HBM3e
WD	与KIOXIA合并谈判将于4月底重启
Murata	库存调整已完成，终端需求恢复
Skyworks	24Q2看好AI应用带来射频产品升级需求
Qorvo	预计2024年手机销量个位数增长，5G增长超10%
华为海思	5nm或8月开始大规模交付
福建晋华	赢得美国司法部诉讼
盛群	上半年不会再调整MCU价格
思瑞浦	2023年工业、通信等终端市场模拟芯片需求未见明显复苏

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

2月，消费类代工订单趋稳，整体产能利用率仍维持低位。

图表 12：2月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	2月产能利用率	2月动态	3月价格趋势
台积电	85%	CoWoS产能翻倍仍供不应求	稳定
三星	70%-80%	HPC订单快速增长；24Q1代工盈利低迷	下降
联电	60%	消费下游市场趋于稳定，汽车和工业持续消化库存；24Q1产能利用率约60%	下降

厂商	2月产能利用率	2月动态	3月价格趋势
中芯国际	70%-80%	23Q4 CIS 和 ISP 产能供不应求，DDIC 和 TDDI 需求增长；预计 2024 年半导体行业需求不会明显复苏	下降
格芯	60%-70%	获得美国商务部 15 亿美元补贴	稳定
世界先进	50%	Q1 晶圆出货量季减 6%-8%	下降
力积电	60%	与印度 Tata 建印度首座 12 英寸工厂	下降
华虹	80%-90%	CIS 和 PMIC 订单有所复苏，24H2MCU 复苏	下降

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

2月，行业持续复苏，AI 相关订单成厂商布局重点。

图表 13：2 月主要封测厂商最新动态

厂商	2 月产能利用率	2 月动态	3 月订单预测
日月光	60%-65%	拟收购 Infineon 两座封测厂；AI 相关高端先进封装收入将翻倍	上升
长电科技	70%-80%	23Q3 以来手机相关营收上升；24Q4 订单总额恢复到上年同期水平	稳定
通富微电	75-85%	2023 年公司营收呈逐季走高趋势	稳定
华天科技	85%	参股 GTI 公司 AI 产品未实现量产	下降
气派科技	65%-70%	2023 年净利润约-1.32 亿元	下降
中小封测厂	50%-60%	订单有增长	下降

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

2 月，行业需求不确定性较大，AI 相关品类需求强劲。

图表 14：2 月主要元器件分销商最新动态

厂商	2 月动态
Arrow	工业需求持续疲软
Avnet	当前行业需求不确定性较多
大联大	自动化及汽车电子需求增长明显
文晔科技	24Q1 服务器需求强劲，工业小幅增长，汽车需求持平
中电港	旗下 iCEasy 商城有涉及跨境电商业务
香农芯创	存储订单需求上升
商络电子	代理 Renesas 相关 AI 应用产品
雅创电子	拟收购分销商 Willas Array 全部股份

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

2 月，工控厂商加速 AI 布局，Tier1 和消费电子 ODM 厂商电气化转型提速。

图表 15：2 月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	2月动态
工控	ABB	发布新一轮 AI 战略，加速 AI 应用布局
	霍尼韦尔	2023 年底未交货订单额达 318 亿美元
	施耐德电气	强化在华研发实力，落地更多研发机构
	罗克韦尔	与轮胎巨头 PTG 签订智能化工厂合作
	汇川技术	中大型 PLC 是公司重点拓展产品之一
汽车	电装	看好汽车电动化需求
	大陆	将裁员超 7000 人
	博世	计划再次大裁员
	现代摩比斯	预计 2024 年订单强劲增长
	安波福	减持自动驾驶公司 Motional 股份
	采埃孚	公司电机产量突破 300 万台
	博格华纳	预计 2024 年电动产品营收从去年约 20 亿美元增长到 25 亿美元以上
消费电子	闻泰科技	承接三星 2024 年超 4000 万部手机 ODM 订单
	华勤技术	拥有汽车电子产品全栈式研发能力
	立讯精密	预计 2023 年净利润 107.67 亿元至 112.25 亿元
	歌尔股份	积极跟进汽车电子领域内的业务机会
	鸿海	印度子公司拟 44 亿新台币投建厂房

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

2月，消费电子需求维持稳定，AI 成手机/PC 市场新增长点，苹果 MR 新品需求放缓。

图表 16：2 月消费电子厂商最新动态

类别	企业	2 月动态
智能手机	苹果	23Q4 中国大陆 iPhone 销量未达目标
	三星	移动设备需求改善；24Q1 手机延续复苏态势
	华为	P70 系列加单 50%，大举备货豪威 CIS 芯片
	OPPO	公司资源将向 AI 手机集中
	小米	昌平智能手机工厂落成投产
	传音	推出手机 AIOS
PC	联想	AI PC 产品快速渗透
	惠普	PC 市场将在 2024 年企稳
	戴尔	预计 PC 复苏将延续至下半年
	小米	拟退出印度笔记本电脑市场
VR/AR	Meta	与 LG 合作开发下一代 XR 设备
	苹果	Vision Pro 在美需求放缓
	三星	拟年底推 XR 设备

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

2 月，新能源汽车价格战再起，苹果取消造车计划，行业集中度提升。

图表 17：2 月新能源汽车厂商最新动态

厂商	2 月动态
比亚迪	开启新一轮电车价格战；计划在墨西哥新建电车工厂
特斯拉	仍在与泰国就投资进行谈判
本田	本田中国将大规模人员优化
大众	2023 年纯电动汽车交付量劲增 35%达到 77.1 万辆
宝马	在泰国启动电池组装厂建设
奔驰	放弃全面电动车计划
丰田	投资 22 亿美元扩产混动车
福特	计划引入 800V 快充技术
Stellantis	考虑在意大利生产零跑汽车

厂商	2月动态
广汽埃安	2月销量 16676 台，环比下滑 33.2%，同比下滑 44.6%
吉利	拟 5.04 亿元出售睿蓝汽车 45%股权
奇瑞	传公司拟进行大规模裁员
理想	2023 年营收 1238.5 亿元，同比增长 173.5%
长城	计划整合电车品牌
华为	与东风猛士就智能汽车达成合作
小米	小米汽车最快 Q2 开始交付
小鹏	投资 AI 近 5 亿美元
苹果	取消电动汽车造车计划

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

2月，中国工控市场需求延续低迷，关注行业 AI 化进展对供应链影响。

图表 18：2月工控厂商最新动态

厂商	2月动态
施耐德电气	2023 年工业自动化营收下降了 1.7%，中国市场出现中个位数下降
欧姆龙	将在全球裁员 2000 人
汇川技术	积极布局海外市场
英威腾	苏州工厂筹备建设三期项目
禾川科技	海外业务布局较晚，占比较小
埃斯顿	AI 化是机器人未来发展方向之一
中控技术	将发布首个工业 AI 生成式大模型

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

2月，光伏行业库存去化持续改善，部分厂商海外订单有所复苏。

图表 19：2月光伏厂商最新动态

厂商	2月动态
----	------

厂商	2月动态
阳光电源	2023年光伏逆变器出货约120-140GW
天合光能	2023年公司营业收入1135.10亿元，同比增长33.46%
锦浪科技	2023年10月以来逆变器需求好转
固德威	24H1公司海外市场逆变器订单和排产已逐渐提升
德业股份	库存有所改善
昱能科技	24Q2库存好转

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

2月，欧洲等主要市场库存压力较大，Q1储能需求有改善。

图表 20：2月储能厂商最新动态

厂商	2月动态
阳光电源	2023年公司登顶海外市场储能PCS出货量榜首
科士达	欧洲户储市场竞争增加
上能电气	2023年公司在中国市场储能PCS出货量第二
科陆电子	与三菱签署美洲市场合作开发协议
德业股份	欧洲户储库存较高
锦浪科技	欧洲库存压力较大，预计24Q1储能需求改善
固德威	预计24H1公司储能库存去化接近尾声
科华数据	2023年公司登顶中国市场储能PCS出货量榜首
天合光能	预计24Q2公司储能产品产能将提升至25GWh

资料来源：芯八哥整理

(6) 服务器

2月，生成式AI带动相关服务器及上游芯片需求强劲，HBM等高附加值产品的销量大幅提升。

图表 21：2月服务器厂商最新动态

企业	2月动态
----	------

企业	2月动态
英伟达	特供 H20 芯片已可接受预订
AMD	23Q4 EPYC 系列处理器在服务器市场份额达 31.1%
三星	24Q1 服务器出现复苏，高端服务器需求保持强劲，HBM 产品销量上升
戴尔	2023 年 AI 服务器备货量达 2 万台
广达	搭载 H200 的 AI 服务器预计 Q3 量产
鸿海精密	供应苹果 AI 服务器在测试；拟扩大 AI 服务器产线；2024 年 AI 芯片有短缺风险

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

2月，通信端客户需求低迷，头部厂商开启新一轮裁员。

图表 22：2月通信厂商最新动态

企业	2月动态
华为	拟 2024 年商用 5.5G 核心网解决方案
中兴通讯	发布全球首台算力路由器
诺基亚	Cloud RAN 解决方案将于 2024 年投入商用
爱立信	AT&T 部署创新 Cloud RAN 技术
思科	通信客户需求疲软；将裁员 4000 人，并降低年度收入目标

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

2月，MCU 市场行情趋稳，看好 AI 相关品类需求，智能手机复苏下 CIS 需求快速增长。

图表 23：2 月细分市场机会关注

产品	市场机会	相关企业
MCU	台厂上半年不会再调整 MCU 价格	ST、NXP 及合泰等
AI 芯片等	AWS、Meta、谷歌正在数据中心建设上展开大规模“军备竞赛”	NVIDIA、SK Hynix 及 Samsung 等
CIS	24Q1 高像素 CIS 订单将保持强劲	索尼、Samsung 及 OV 等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

2 月，关注各国行业政策、光伏行情变化对于上游元器件影响，警惕 MLCC 和 DRAM 价格波动风险。

图表 24：2 月细分市场风险预警

产品	风险预警	相关企业
IGBT	欧洲最大光伏组件生产商 MBT 将关闭德国厂	Infineon、斯达半导体及时代电气等
MLCC	订单需求放缓，预计 Q1 MLCC 出货环比减少 7%	Murata、TDK、国巨及顺络等
DRAM	中国客户接受提价，DRAM 价格连续上涨	Samsung、SK Hynix 及 Micron 等
汽车电子零部件	美国商务部以安全为由调查中国组装智慧联网汽车	比亚迪等头部供应商

资料来源：芯八哥整理

六、小结

2 月，随着消费电子等终端需求温和复苏，车规级芯片交期和价格大幅修复，半导体市场趋势向好。值得关注的是，XR 需求不如预期，工业和通信需求持续低迷，汽车芯片库存有所上升，新能源库存压力仍存，AI 需求潜力爆发。

近期，频频出现半导体产业链相关企业的裁员或倒闭的声音。短期内，半导体行业低谷已过，但未来未至。芯八哥建议重点关注 AI 在智能手机、PC、汽车及工控等领域应用机会。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2024年03月



扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、厂商动态和行业趋势报告



加入芯八哥半导体行业交流群

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、行业白皮书免费领取

华强电子网集团是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网 B2B 综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以“线上+线下”相结合的 B 端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的**全球采购服务**和**综合信息服务**，致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业链交易效率和客户服务水平的提升。

未来，华强电子网集团将通过与物流、资金流、信息流以及自身优势多元产业链的深层次合作和优势互补，围绕电子元器件及相关产品垂直应用领域，通过不断创新服务内容，进一步构建多层次、满足长尾采购需求的现货大生态，致力于打造世界级的电子元器件产业互联网平台。





华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group



芯八哥

电子元器件产业互联网平台

www.hqengroup.com 

更高效 更透明 重构产业生态

元器件采购 | 产品信息展示 | 仓储服务 | BOM工具
品牌推广 | SaaS | PCB制板